

2058703-1 ✓ AKTIV

LUMAWISE

Interne TE-Nummer 2058703-1

PCB Mount Hermaphroditic Connector, Right Angle, Board-to-Board, 2 Position, 4 mm [.157 in] Centerline, Tin, Surface Mount, Power, Natural

[Auf TE.com ansehen>](#)



Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Leiterplattenstiftleisten und -buchsen



PCB-Steckverbindermontagetyp: **Zwittersteckverbinder für die Leiterplattenmontage**

Montageausrichtung für Leiterplatte: **Rechter Winkel**

Steckverbindersystem: **Leiterplatte-an-Leiterplatte**

Anzahl von Positionen: **2**

Zeilenanzahl: **1**

Eigenschaften

Produktmerkmale

PCB-Steckverbindermontagetyp	Zwittersteckverbinder für die Leiterplattenmontage
Steckverbindersystem	Leiterplatte-an-Leiterplatte
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Stapelbar	Nein
Ladungszustand des Steckverbinderkontakts	Voll bestückt
Montageausrichtung für Leiterplatte	Rechter Winkel
Anzahl von Positionen	2
Zeilenanzahl	1
Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration	Parallel

Elektrische Kennwerte

Spannungsfestigkeit (max.)	1500 VAC
----------------------------	----------

Arbeitsspannung	125 VAC
-----------------	---------

Sonstige Eigenschaften

Primäre Produktfarbe	Naturbelassen
----------------------	---------------

Kontaktmerkmale

Kontaktaufbau	Verbindungsstufe
---------------	------------------

Flachkontaktbreite	3.05 mm [.12 in]
--------------------	------------------

Flachkontaktdicke	.4 mm [.016 in]
-------------------	-----------------

Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Zinn
---	------

Kontaktmaterial	Kupferlegierung
-----------------	-----------------

Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Zinn
--	------

Kontakttyp	Zwitter
------------	---------

Kontakt-nennstrom (max.)	6 A
--------------------------	-----

Klemmenmerkmale

Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restdicke	.4 mm [.016 in]
---	-----------------

Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restbreite	1 mm [.04 in]
--	---------------

Verbindungsmethode für Leiterplatte	Oberflächenmontage
-------------------------------------	--------------------

Montage und Anschlusstechnik

Montageausrichtungstyp für Leiterplatte	Keine
---	-------

Gegensteckführung	Ohne
-------------------	------

Arretierung für Leiterplattenmontage	Ohne
--------------------------------------	------

Montageausrichtung der Leiterplatte	Ohne
-------------------------------------	------

Art der Steckverbinder-montage	Leiterplattenmontage
--------------------------------	----------------------

Gehäusemerkmale

Raster	4 mm [.157 in]
--------	----------------

Gehäusematerial	LCP
-----------------	-----

Abmessungen

Steckverbinderhöhe	3.9 mm
--------------------	--------

Leiterplattendicke (empfohlen)	1.57 mm [.062 in]
--------------------------------	-------------------

Verwendungsbedingungen

Gehäusenenn-temperatur	Hoch
------------------------	------

Betriebstemperaturbereich	-40 – 105 °C [-40 – 221 °F]
---------------------------	-----------------------------

Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung	Leistung
----------------------	----------

Industriestandards

Behörde/Norm	CSA
Zugelassene Standards	CSA LR7189, UL E28476
UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

Verpackungs-Typ	Band und Rolle
-----------------	----------------

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die [Produktseite auf TE.com](#) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2023 (235) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2022 (223) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Noch nicht auf den Halogengehalt überprüft
Lötfähigkeit	Reflow-Löten tauglich bis 260 °C

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



Kunden kauften auch diese Produkte



Dokumente

Produktzeichnungen

Herm Blade & Recp Assy, 2 Pos,Latch

Englisch

CAD-Dateien

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_2058703-1_A.2d_dxf.zip](#)

Englisch

[3D PDF](#)



3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_2058703-1_A.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_2058703-1_A.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

[HERMAPHRODITIC_WIRE-TO-BOARD_AND_BOARD-TO-BOARD](#)

[HERMAPHRODITIC_WIRE-TO-BOARD_AND_BOARD-TO-BOARD](#)

Englisch

Produktspezifikationen

[Anwendungsspezifikation](#)

Englisch

[Anwendungsspezifikation](#)

Englisch

Freigabe Agentur

[UL-Bericht](#)

Englisch